

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2024-032

## 合肥新汇成微电子股份有限公司

### 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金项目结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本事项无需董事会审议。具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 166,970,656 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.88 元，募集资金总额为 1,482,699,425.28 元，扣减承销费 128,269,942.53 元（不含增值税）、保荐费 3,000,000.00 元（不含增值税）后的募集资金为 1,351,429,482.75 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,069,835.33 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,320,359,647.42 元。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 8 月 12 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕412 号）。

## 二、募集资金投资项目情况

公司于2022年8月26日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。由于公司首次公开发行实际募集资金净额132,035.96万元少于招股说明书披露的拟投入的募集资金金额156,386.99万元。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目使用募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）。调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资预算总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	项目实施主体
1	12吋显示驱动芯片封测扩能项目	97,406.15	97,406.15	78,000.00	汇成股份
2	研发中心建设项目	8,980.84	8,980.84	5,000.00	汇成股份
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	49,035.96	汇成股份
合计		<b>156,386.99</b>	<b>156,386.99</b>	<b>132,035.96</b>	-

公司于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
12吋显示驱动芯片封测扩能项目	2022年12月	2023年12月
研发中心建设项目	2023年06月	2023年09月

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2023年5月31日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。

### 三、募集资金投资项目资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金及其产生的利息收入使用情况具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度	节余金额
1	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	78,000.00	78,493.88	100.63%	0.00
2	研发中心建设项目	5,000.00	5,047.37	100.95%	0.00
3	补充流动资金	49,035.96	49,036.40	100.00%	0.00
合计		<b>132,035.96</b>	<b>132,577.65</b>	<b>100.41%</b>	<b>0.00</b>

公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行	1302045719100295856	0.00	已销户
2	华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001168508	0.00	已销户
3	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100365322	0.00	已销户
4	招商银行股份有限公司合肥分行	514902669010558	0.00	已销户
合计		-	<b>0.00</b>	

公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕，并已于 2023 年 10 月份注销全部募集资金专户，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-057）。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”与“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”已分别于 2023 年 9 月和 2023 年 12 月达到预定可使用状态，公司拟将首次公开发行股票募投项目全部结项。

#### 四、本次募集资金投资项目结项的相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 5.3.10 条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日